

ADVANTEST®

中長期経営方針説明会

「グランドデザイン」(2024年度改定版)と第3期中期経営計画(MTP3)

2024年6月25日

代表取締役 兼 経営執行役員 Group CEO Douglas Lefever

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準(IFRS)に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(改変、複製、転用等)することを禁止します。

- ▶ **“Era of Complexity”**
複雑性の時代と新たなビジョン・ステートメント
- ▶ **第3期中期経営計画**
 - ▶ 4つの戦略
 - ▶ 経営指標(財務目標)

世界半導体市場



Source : TechInsights Inc.

半導体産業に複雑性をもたらすメガトレンド

メガトレンド

- ✧ テクノロジーの進化
- 🌿 環境課題
- 🌐 地政学的リスク

ハイエンド / 高性能
半導体需要の増加

X

サプライチェーンや
エコシステムの再編

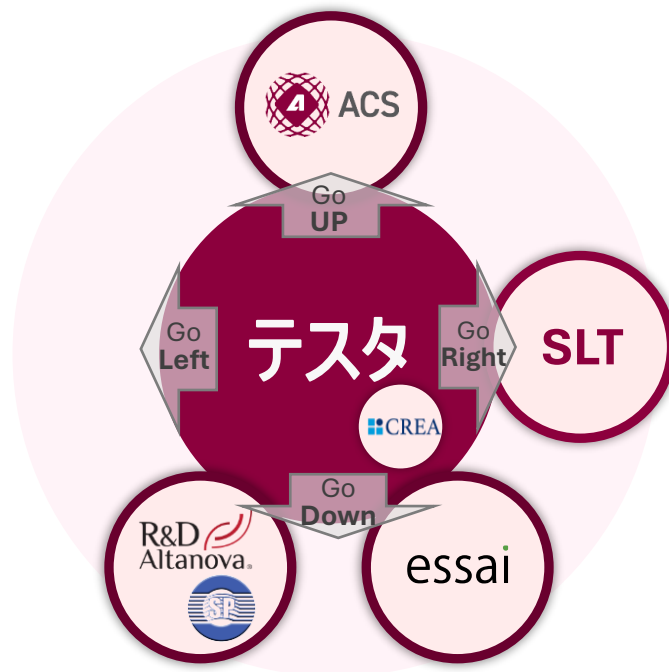


MTP1&2 : コア事業強化、近縁市場への拡大、グローバル・サポート強化を推進

1 製品ポートフォリオ拡充

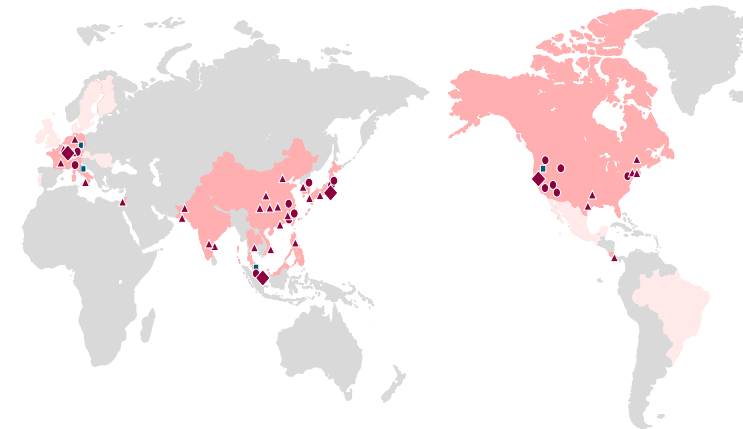
	データセンタ ・AI	自動車	産機・IoT	スマートフォン PC・AR・VR
	Cloud		Edge	
HPC	V93000 Digital			
Power Device	V93000 PAC			
RF	V93000 WSRF			
HBM	T583X			
DRAM/ NVM	T583X / T5503HS2			
Image Sensor	T2000 ISS			
Display Driver	T6391			

2 近縁市場への拡大



3 グローバル・サポート力増強

	>1,000 顧客拠点数
	>7,000 従業員数
	>50 18地域を網羅した拠点数



顧客や市場からの評価

半導体テスト市場における当社シェア

2017年

2023年

36% → **58%**

売上高

2017年度

MTP2実績
(2021-23年度 平均)

2,072億円 → **4,879**億円

時価総額

2018年3月

2024年5月

4,000億円 → **4兆円**

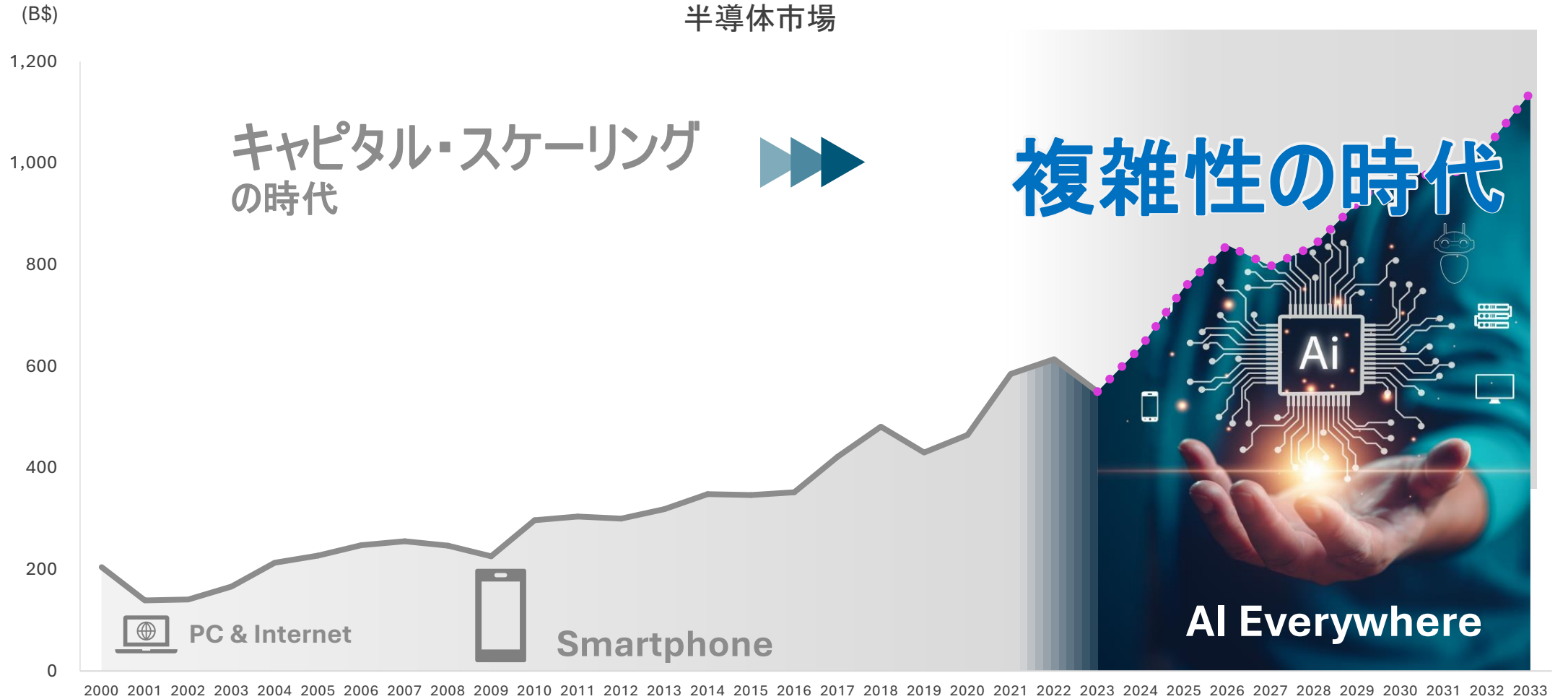
顧客満足度



半導体製造装置メーカーに対する顧客満足度調査において、**5年連続首位**

半導体産業の変化

半導体市場

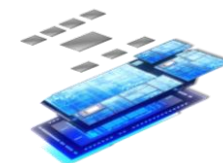


Source: TechInsights Inc.

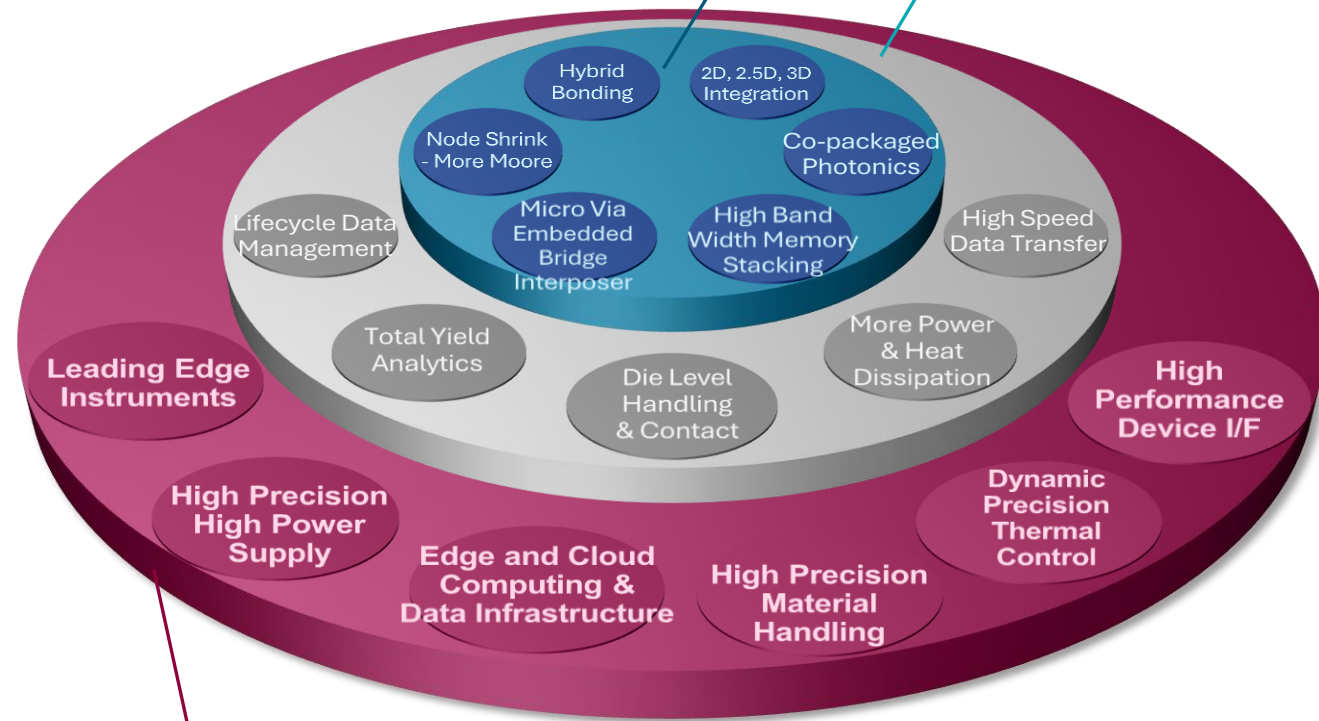
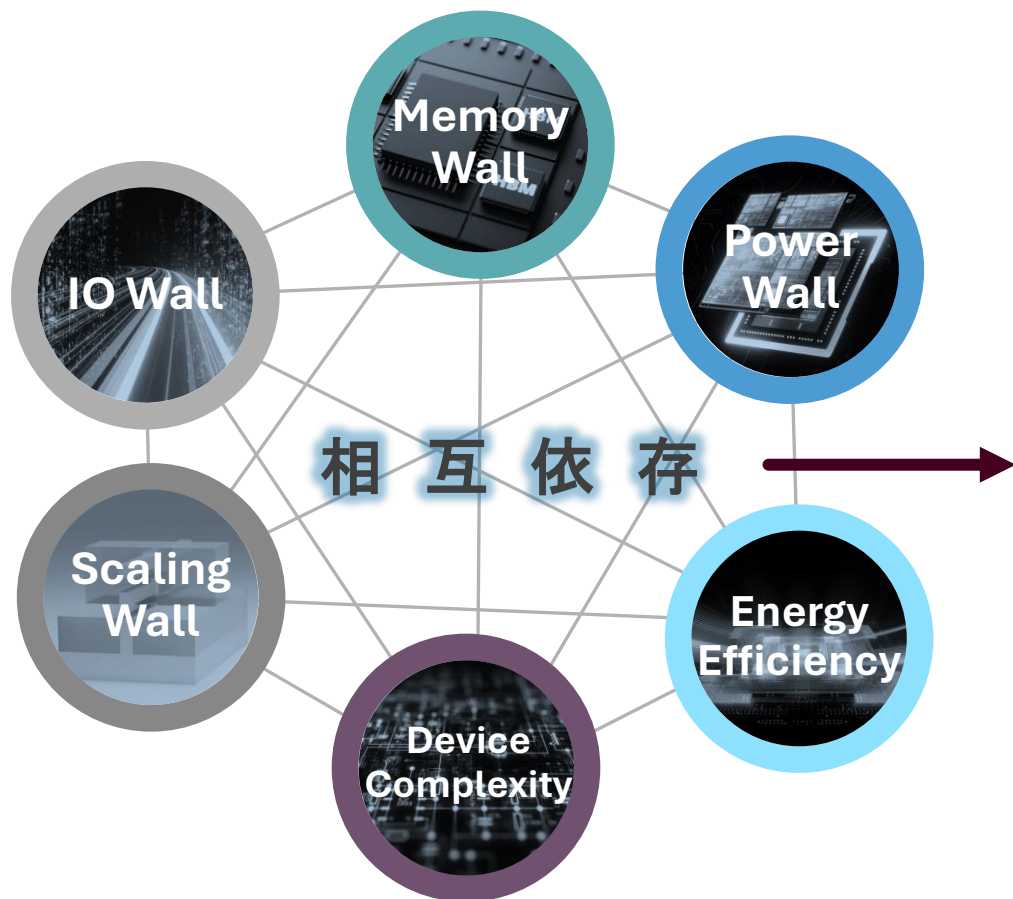
加速する「複雑性」:テクノロジー

ますます増加する 半導体試験の複雑性

3D チップレット、
ヘテロジニアス・
インテグレーション



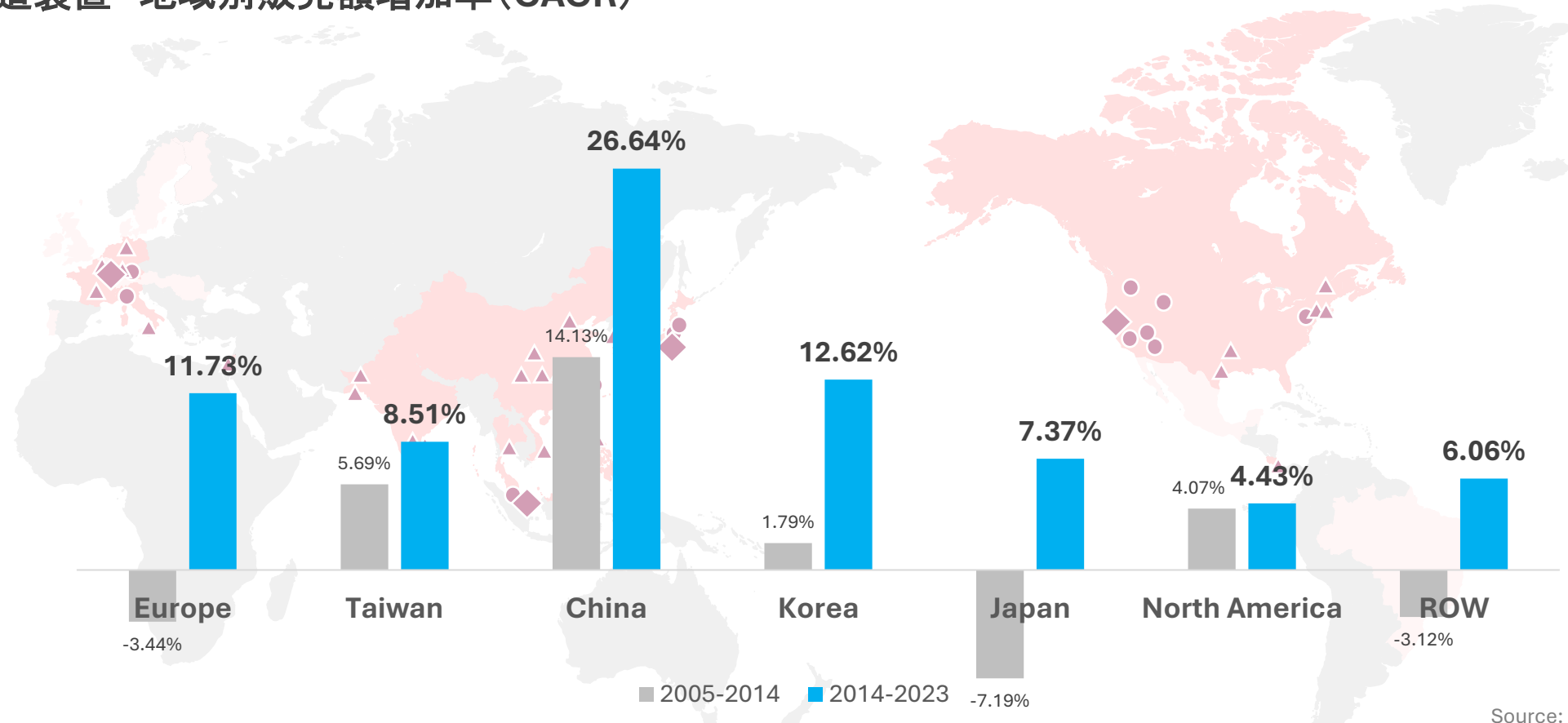
半導体試験の課題



当社の技術ポートフォリオ拡充を継続

加速する「複雑性」: サプライチェーン


半導体製造装置 地域別販売額増加率(CAGR)



Source: SEAJ, SEMI, SEMI Japan

- アドバンテスト拠点
- ◆ 地域統括拠点
 - 研究開発/製造拠点
 - ▲ 販売・サポート拠点

新たなビジョン・ステートメント

A pair of hands is shown in silhouette, cupping a glowing blue and white globe of the Earth. The globe is overlaid with a complex network of white lines and dots, representing a global network or data flow. The background is a dark blue sky with a soft, golden glow emanating from behind the hands, suggesting a sunrise or sunset.

半導体バリューチェーンで
最も信頼され、最も価値ある
テスト・ソリューション・カンパニーへ

Be the Most Trusted and Valued
Test Solution Company
in the Semiconductor Value Chain

第3期中期経営計画 (MTP3、2024～2026年度)

MTP3の出発点：これまでに築いた市場ポジション



- HPC / AI Chip / GPU
- Network Connection
- High Bandwidth Memory

- Application Processor
- Wireless Communication
- Power / Analog
- High-/Mid-end Memory

← **Advantest is in No.1 Position** →

1

コア市場の成長率を上回る成長実現

2

近縁市場・新規事業領域への展開

3

オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを推進

4

サステナビリティの取り組み強化

戦略 #1 コア市場の成長率を上回る成長実現

優れたテスト・ソリューションの開発を強かに推進



V93000

先進的なテスト・テクノロジーの開発、最先端のデジタル/RF/Power & Analog向けの統合ソリューションの開発

- ▶ Digital/SoC: 高性能デジタル試験の分野でマーケット・リーダーシップを追求
- ▶ RF: IoTからmmWaveまで幅広くカバー
- ▶ Power / Analog: 幅広いアプリケーション・カバレッジ
- ▶ MCU / Sensor: 多数個同時測定



T2000/T6391

ディスプレイ・ドライバーICやCMOSイメージ・センサーなどの特定アプリケーション・デバイス向けテストとして最高の効率性

- ▶ CIS: ヘテロジニアス・コンピューティング技術による画像キャプチャ・モジュールと画像処理ユニットの強化
- ▶ DDIC: マーケット・リーダーとしてすべてのテスト要件をカバー
- ▶ Power / Analog: 幅広いアプリケーション・カバレッジ



Memory

メモリ・テスト・ソリューションの総合プロバイダとしての地位を確固たるものに

- ▶ 次世代高速メモリ・インターフェース対応テストの開発
- ▶ コア試験・ウェハ試験での豊富な試験機能
- ▶ NAND Flashプロトコル、高速・多層3D NAND対応
- ▶ HBMテスト・ソリューション



DH

Featuring
Die level Solution

3Dチップレットに不可欠な最先端のダイ・レベル・ハンドリング・ソリューションの提供

- ▶ 量産用ダイ・レベル・ハンドリング
- ▶ ダイ・テストへのActive Thermal Controlの適用
- ▶ HBMダイ・キャリア・ソリューション



SLT / Burn-in

半導体のエンド・ユースをエミュレートするSLTの強化により、当社の製品ポートフォリオのテスト・カバレッジを拡大

- ▶ Active Thermal ControlをすべてのSoC向けに展開
- ▶ 大量 / 中量生産向けハンドリング・プラットフォームの拡充
- ▶ テスト・アプリケーション・ソフトウェアとデータ解析ソリューションの提供
- ▶ SLT / BIプラットフォームでの構造化テスト・ソリューション

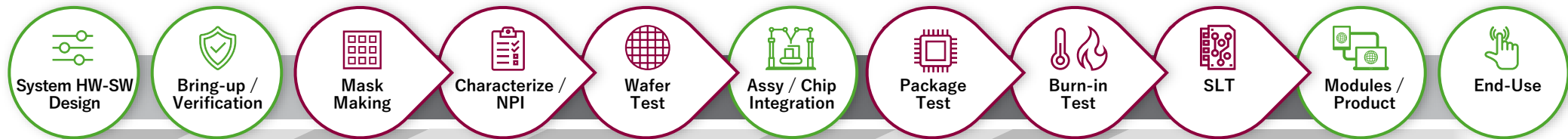


CREA

短絡試験を中心に、EVの電力効率向上に不可欠なパワー半導体テストソリューションを確立

- ▶ SiC / GaN / IGBT
- ▶ 多数個同時測定、IPM、SiPへの対応
- ▶ ウェハ / KGD / モジュール試験ソリューション

“Automation of Test”で半導体産業の課題解決に貢献

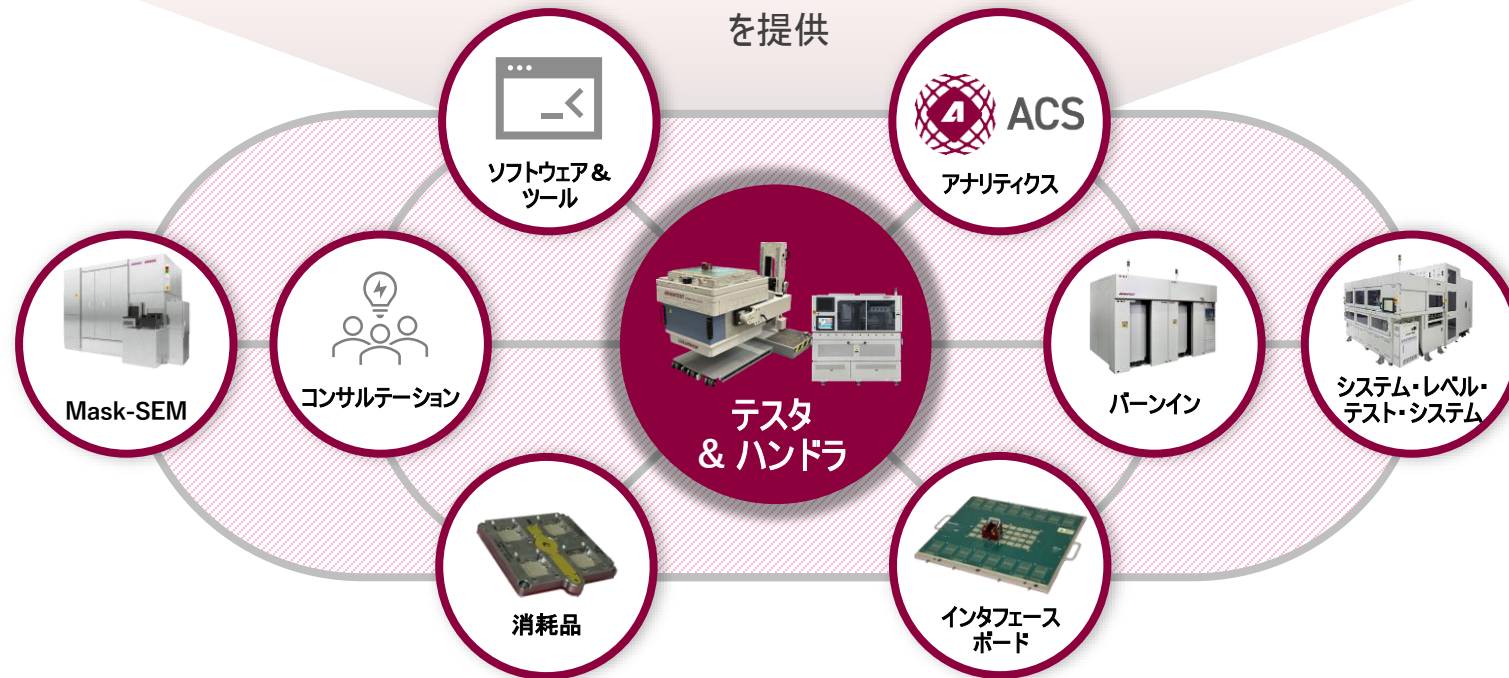


データ・フィードフォワード / フィードバック

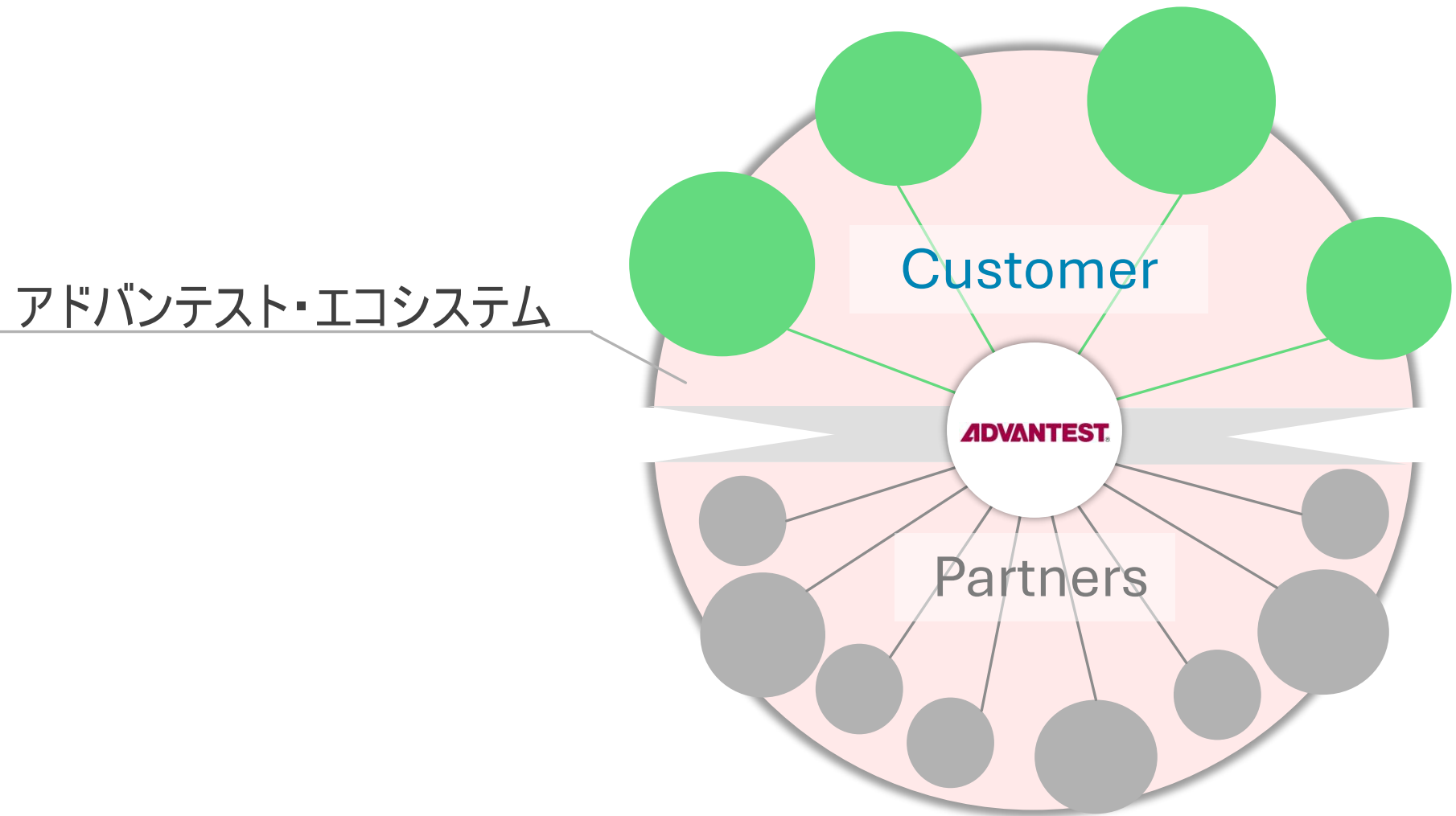
ソリューションを統合し

Automation of Test

を提供



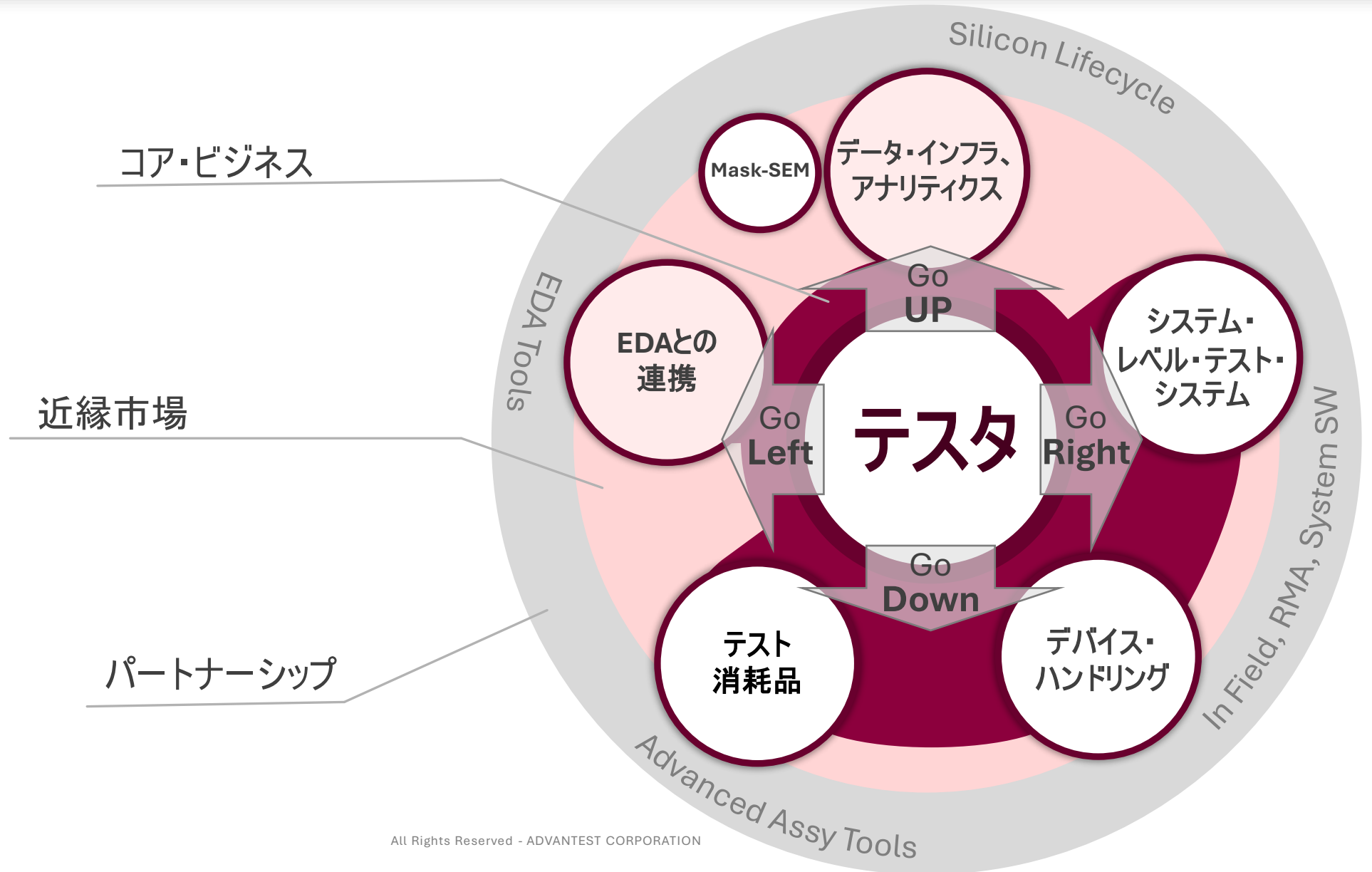
複雑な顧客課題の解決に向け、当社をハブとしたエコシステムを組成



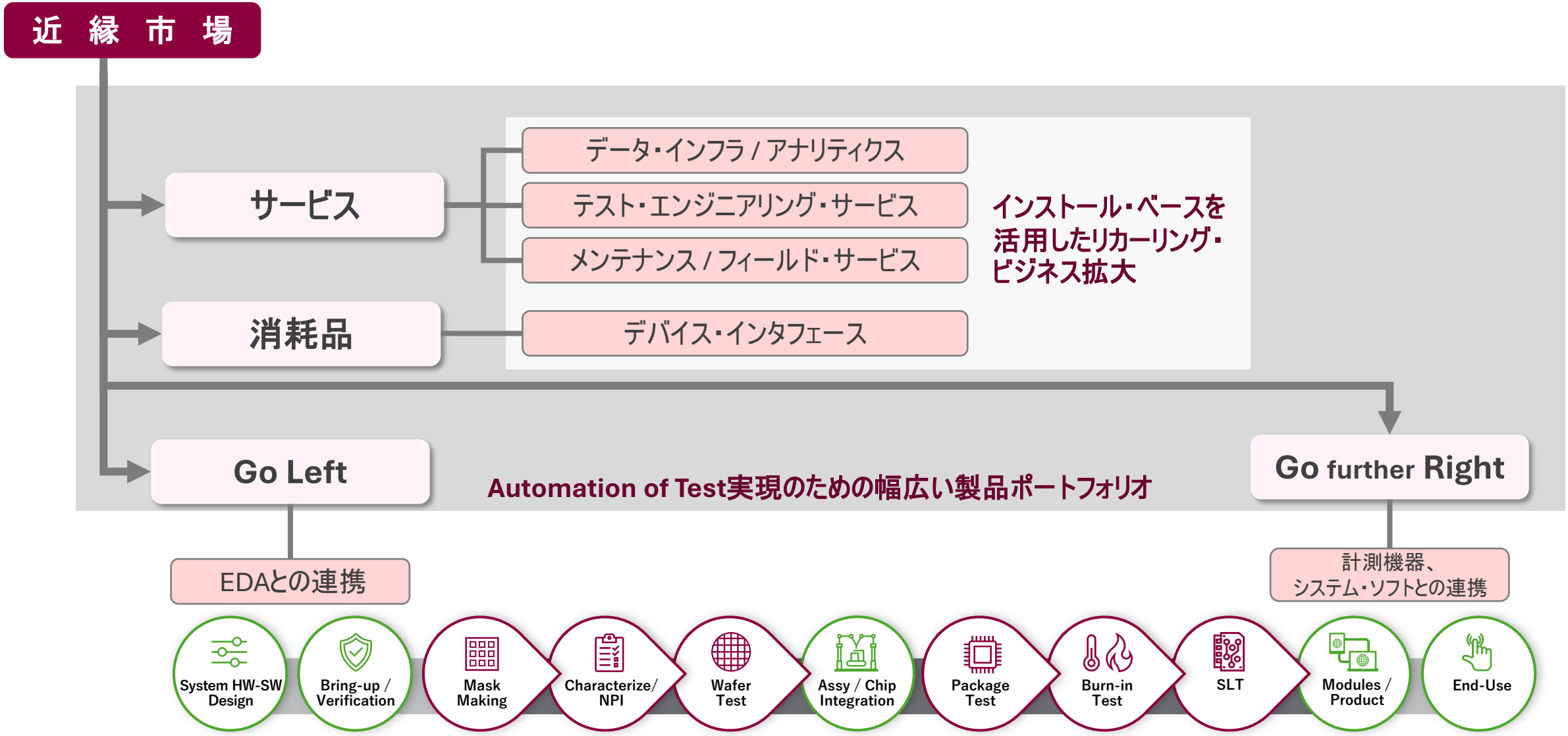
戦略 #2

近縁市場・新規事業領域への展開

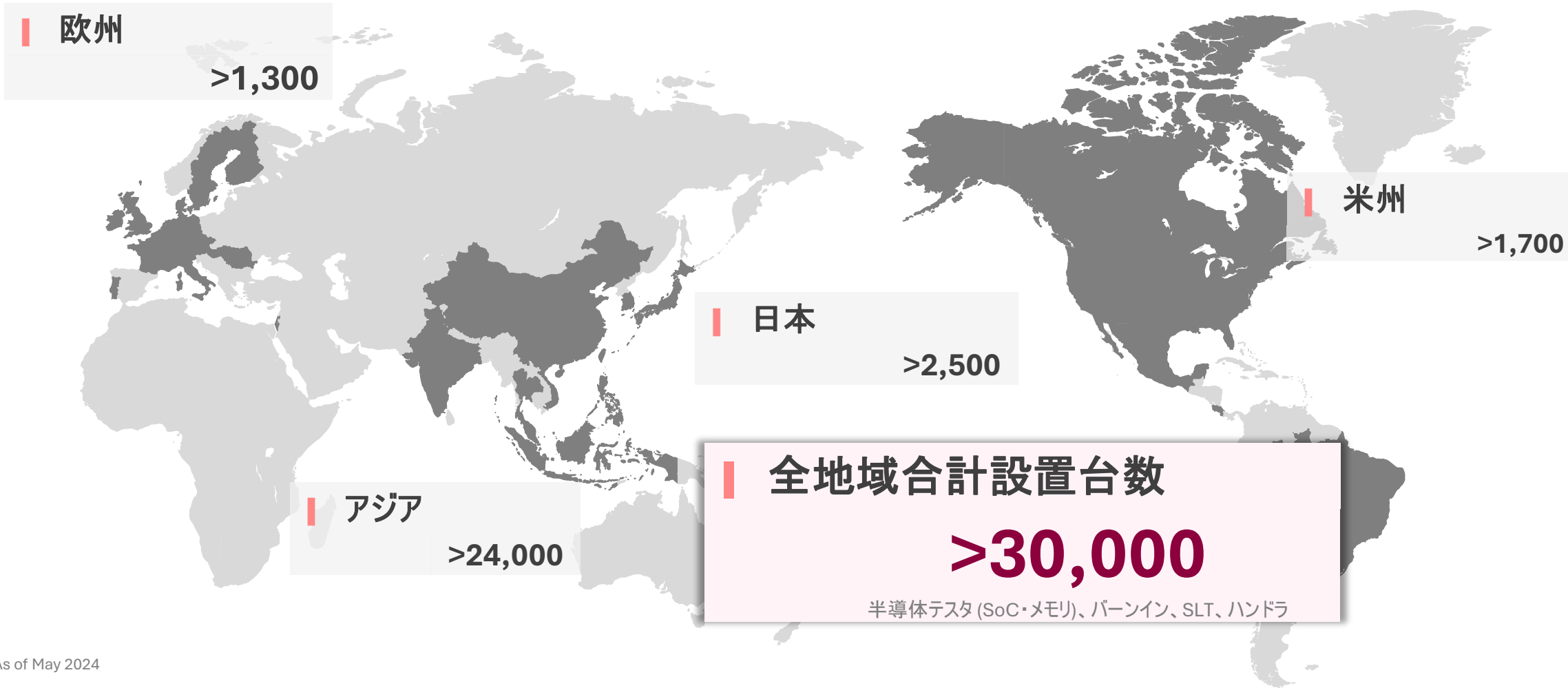
近縁市場への展開でコア事業と“Automation of Test”を強化



近縁市場への展開で、差別化と事業機会創出を実現

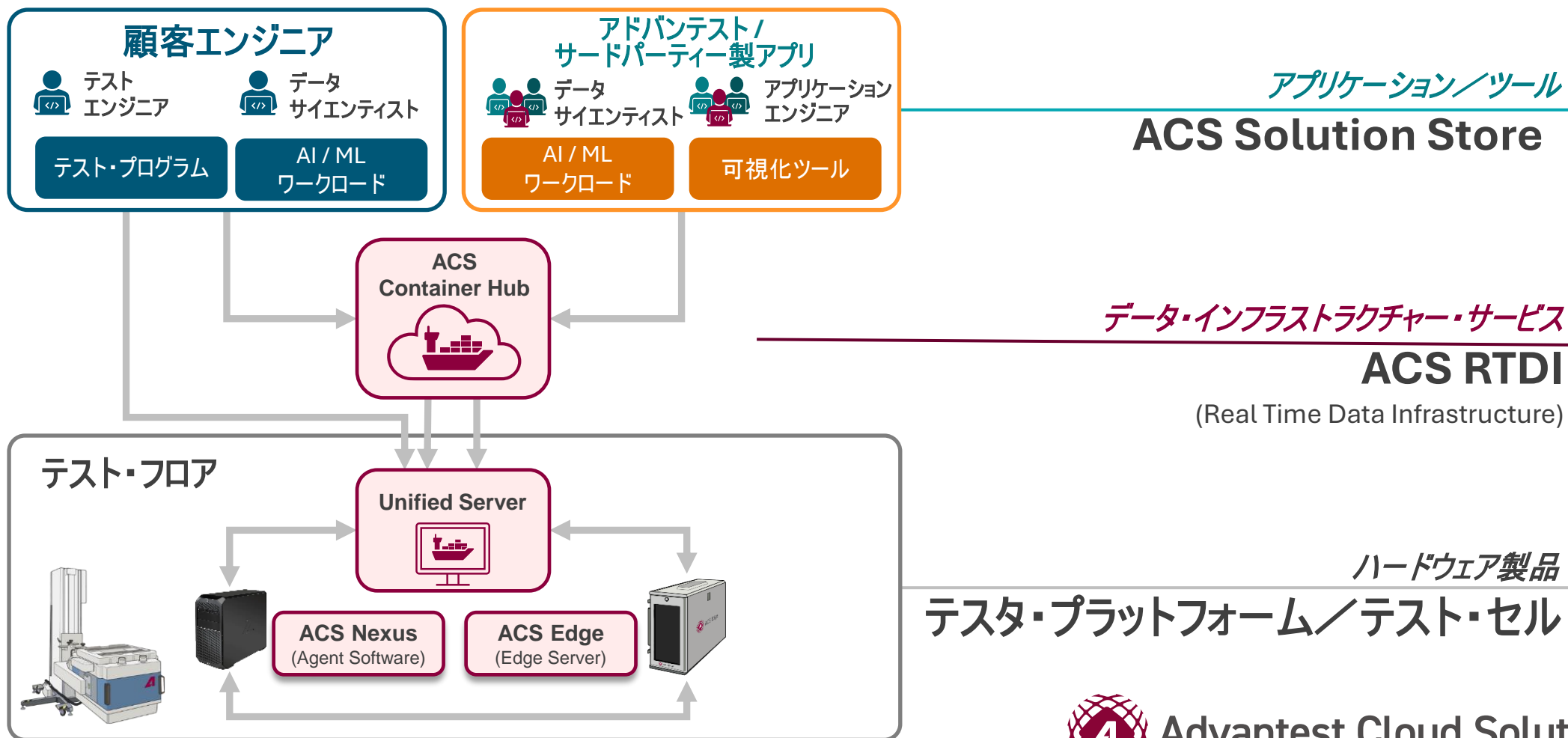


インストール・ベースをサービス事業拡大と顧客ニーズ捕捉に活用



As of May 2024

データ・サービス + アプリケーション・ソフトウェア = ユニークな付加価値



戦略#3 オペレーショナル・エクセレンスへの取り組みを推進

オペレーション・モデル改善の取り組み



デジタル・トランスフォーメーション



サプライチェーン再編



ITインフラ&セキュリティ



全社リスク・マネジメント



財務マネジメント



人財開発

更なる生産性向上

サプライチェーン・レジリエンス

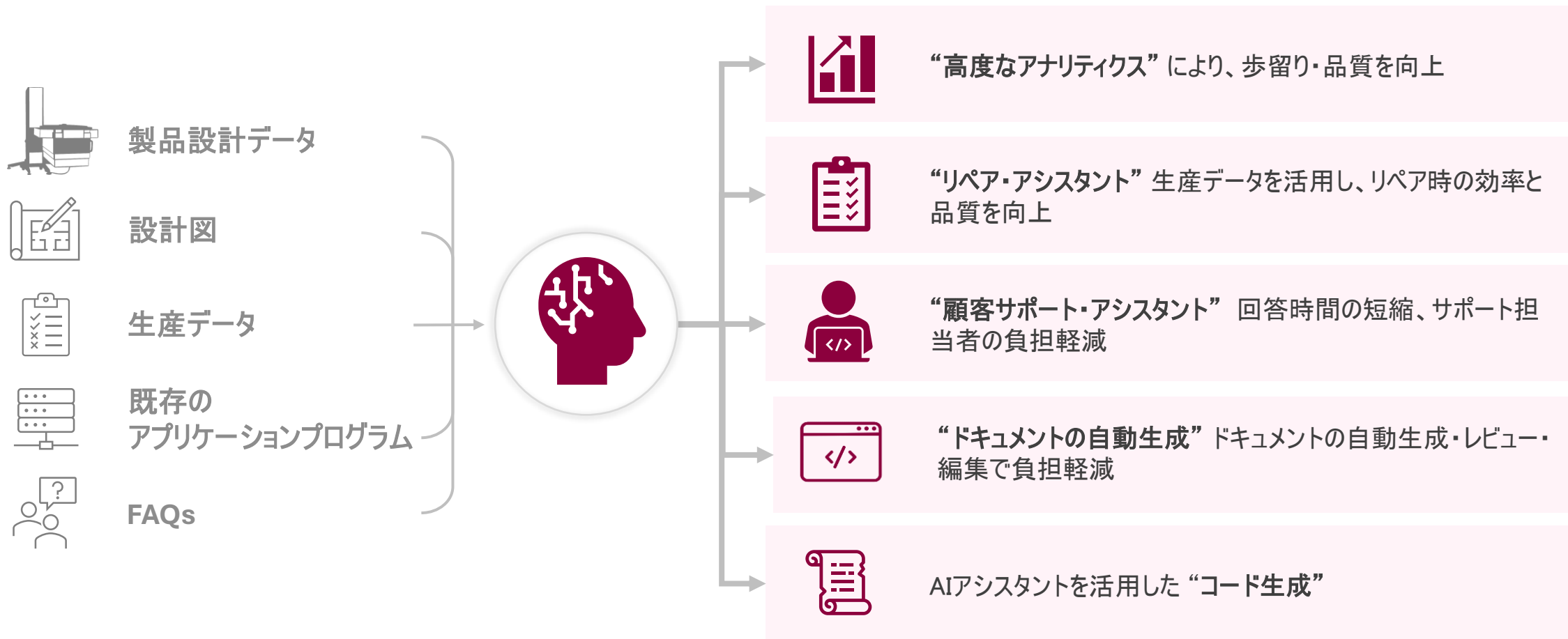
セキュアなIT環境

プロアクティブなリスクコントロール

効果的なコストコントロール

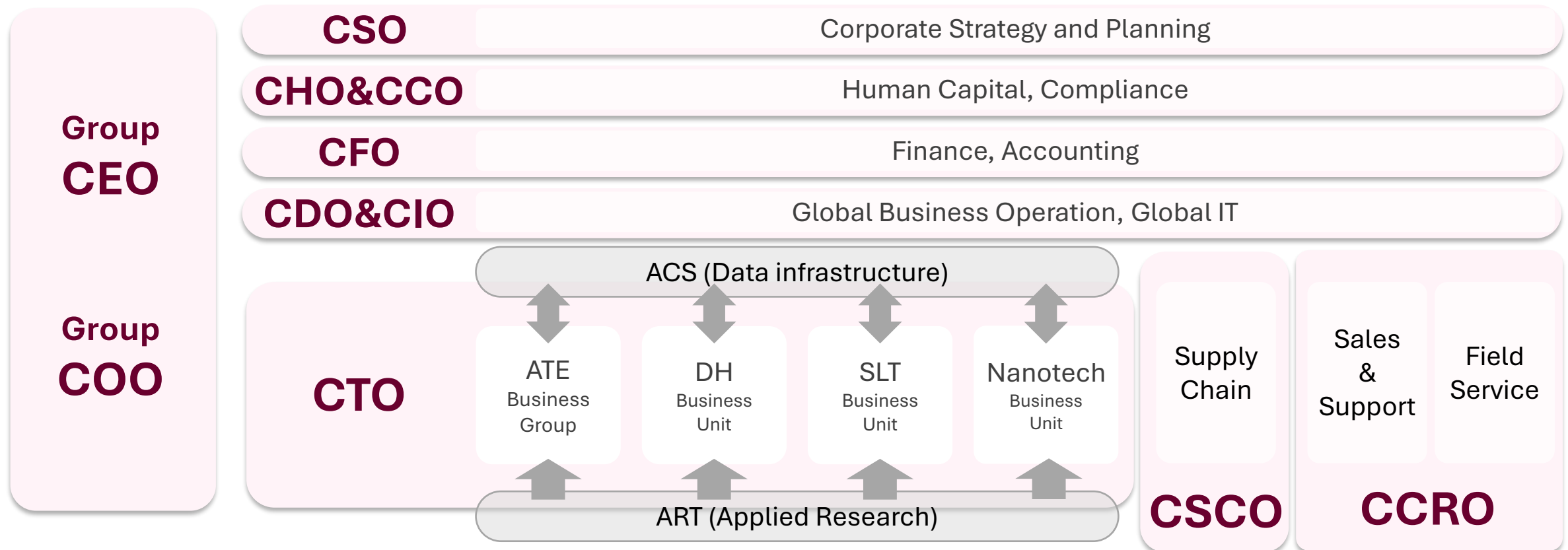
付加価値創出力の強化

戦略的なAI活用による事業価値と収益性の向上



マネジメントの明確なアカウントビリティ

- CxO体制に移行し、あらゆるオペレーションに対するアカウントビリティを明確化



經營指標(財務目標)

半導体市場の見通し



Source: Omdia (AMFT 1Q24 update), TechInsights Inc.

数量的な市場拡大要因

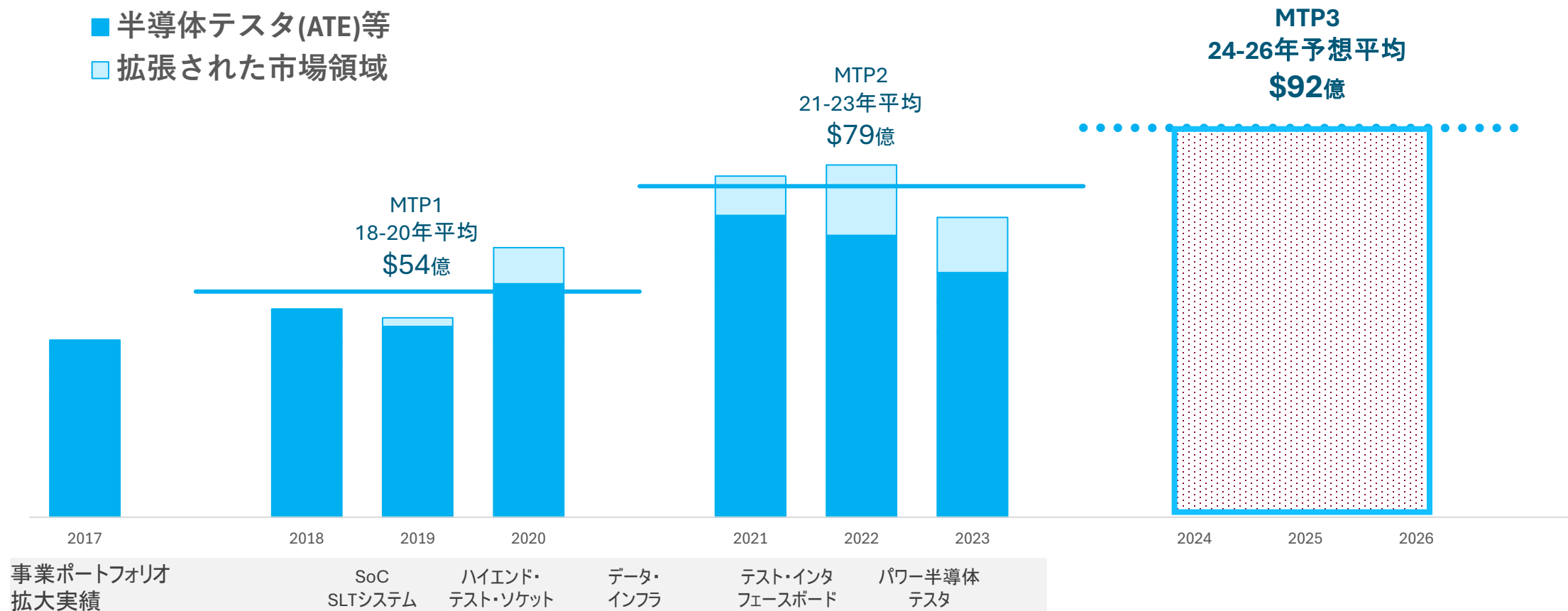
- ▶ AI、EV、エッジ・コンピューティング向け需要の持続的成長
- ▶ コンシューマー機器、産業機器における半導体搭載量の増加、およびそれら用途向けの需要回復
- ▶ 半導体サプライチェーン強靱化に向けた各政府の取り組み

テクノロジー面における市場拡大要因

- ▶ 最先端デバイスにおける更なる微細化、3D化、その他の回路構造の進化
- ▶ GPU/CPU/NPU、ASIC、通信デバイス、HBM、ADAS用半導体の更なる複雑化

広がる当社の「コア市場」

- 当社の市場は半導体テスタ(ATE)、テスト・ハンドラ、テスト周辺機器に過去限られてきたが、この6年間の取り組みにより事業領域を拡大



Source: Advantest, TechInsights Inc., Yole Intelligence 2023

市場前提

	MTP2 実績 (CY21-23平均)	MTP3 想定 (CY24-26平均)	MTP2比
コア市場規模	\$79億	\$92億	+18%
半導体テスタ(ATE)市場規模	\$51億	\$59億	+16%
ATE 市場当社シェア	54%	>58%	>4pts

MTP3 経営指標

	MTP2実績 (FY21-23平均)		MTP3目標 (FY24-26平均)
売上高	4,879億円	▶▶	5,600 - 7,000 億円
営業利益率	24.7%	▶▶	22 - 28 %
当期利益	933億円	▶▶	930 - 1,470 億円
ROIC	25.5%	▶▶	18 - 28 %
1株当たり利益 (EPS)	124円	▶▶	127 - 202 円

* MTP3財務目標値の前提とした為替レート: 1米ドル=140円、1ユーロ=155円

* ROIC = NOPAT ÷ 投下資本(期首・期末平均)。NOPAT: 営業利益 × (1 - 税負担率25%)。投下資本: 借入金 + 社債 + 資本合計 (リース負債含まず)

MTP3 コスト・利益モデル

- 売上総利益率の改善に重点的に取り組む
- 研究開発など、将来の成長に向けた投資を継続しつつも全社的な経営効率改善を推進
- 今後いずれかの年度における営業利益率30%台到達に向け、オペレーティング・モデルを改善

	MTP1 (FY18-20)		MTP2 (FY21-23)		MTP3 (FY24-26)
	目標モデル	実績	目標モデル*	実績	目標モデル
売上高	3,000億円	2,904億円	5,000億円	4,879億円	6,300億円
売上総利益率	54%	55%	57%	55%	53%
売上高販管費比率	32%	33%	28%	30%	28%
(うちR&D費比率)	13%	14%	12%	12%	11%
営業利益率	22%	22%	29%	25%	25%

*2022年7月公表の修正目標の中央値

収益性、資本効率の一層の改善に向けた取り組み

- 売上総利益率の改善、オペレーティング・モデルの改善、資本効率の向上を通じ、MTP3財務目標達成および資本コストを大きく上回るリターンの創出に努める

売上高総利益率の改善

- ▶ 優れたテスト・ソリューションの販売促進
- ▶ サプライチェーン・マネジメントや製造オペレーションの最適化を実施

オペレーティング・モデルと経営効率の改善

- ▶ DXや人的資本強化など、オペレーショナル・エクセレンスを追求する取り組みを通じて業務プロセスを含めた生産性を改善、販管費を最適化

ROICを活用した資本効率の向上と稼ぐ力の改善

- ▶ キャッシュ・コンバージョン・サイクル圧縮を通じ、運転資本を効率化
- ▶ 財務健全性を維持した上で適正な資本構成を図る
- ▶ 事業・投資管理におけるROIC活用の深化により、創造価値を拡大

MTP3 成長投資、株主還元方針

成長投資

- ▶ 今後の成長に向けた事業投資を引き続き優先
- ▶ 研究開発費はMTP2実績から約1.2倍に増強
- ▶ M&Aや業務提携などの戦略投資については、成長戦略に沿った有望案件を引き続き探索

	MTP2実績 (FY21-23累計)	MTP3想定 (FY24-26累計)
研究開発費	1,740億円	約 2,100 億円
設備投資	639億円	約 600 億円
戦略投資	407億円	約 1,000 億円

株主還元

- ▶ 1株当たり通期30円を最低限とする方針のもと安定的・継続的な配当を実施
- ▶ 総還元性向*は、MTP3期間の3年間合計で50%以上を目途とする

	MTP2 (FY21-23累計)	MTP3 (FY24-26累計)
総還元性向 目標	50%以上	50%以上
実績	69%	

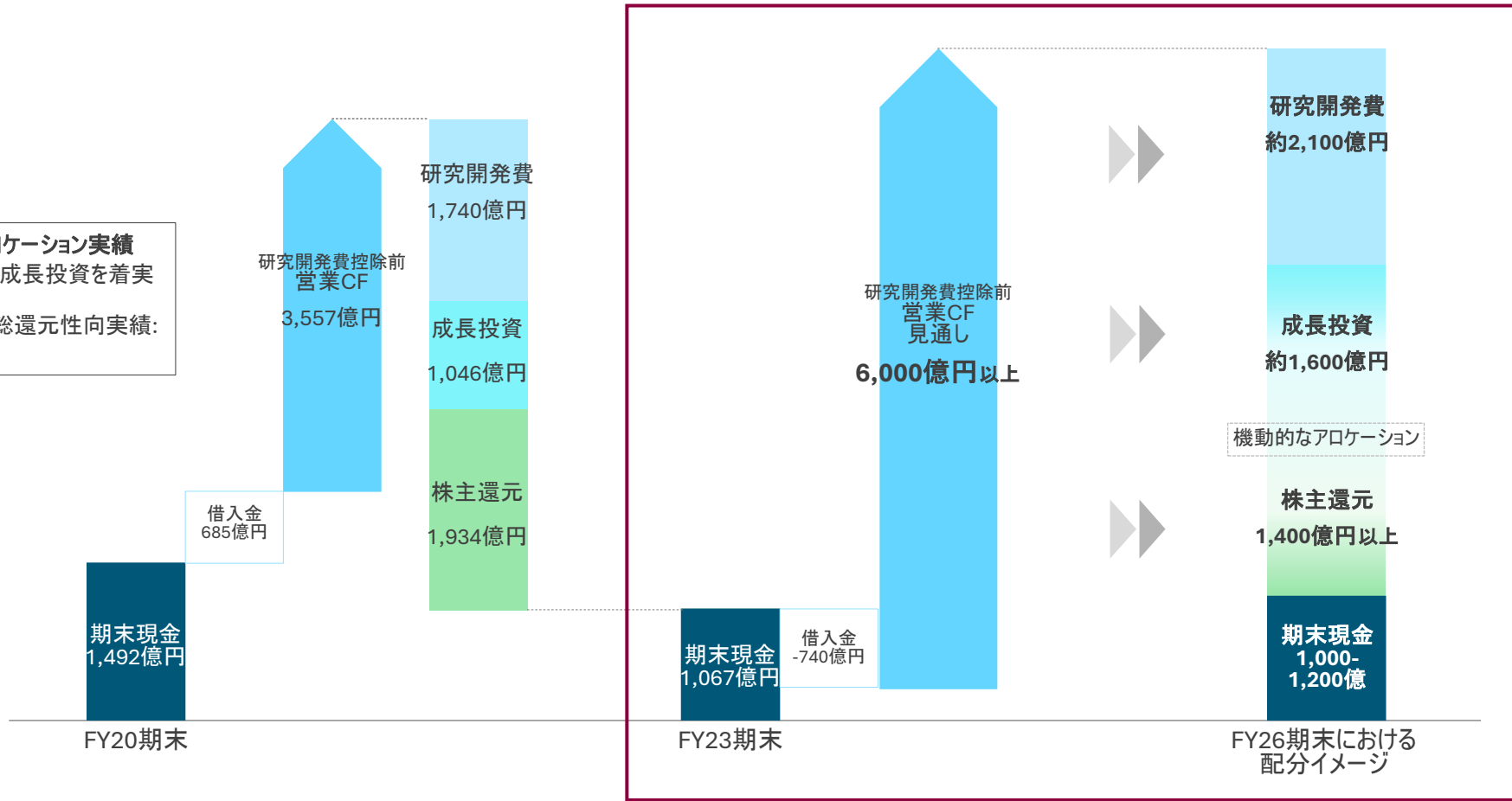
ただし、成長投資機会の発生や事業環境の悪化などにより、これらの株主還元水準は見直される場合があります

*総還元性向: (配当額 + 自己株式取得額) ÷ 連結当期利益

MTP3 キャピタル・アロケーション

- 事業成長投資やM&A等の戦略投資への配分を優先。ただし今後の状況に応じ、追加的な株主還元も柔軟に検討

- MTP2期間のアロケーション実績
 - R&Dを含め、成長投資を着実に実行
 - 当該期間の総還元性向実績: 69%



*成長投資: 設備投資+M&A等の戦略投資

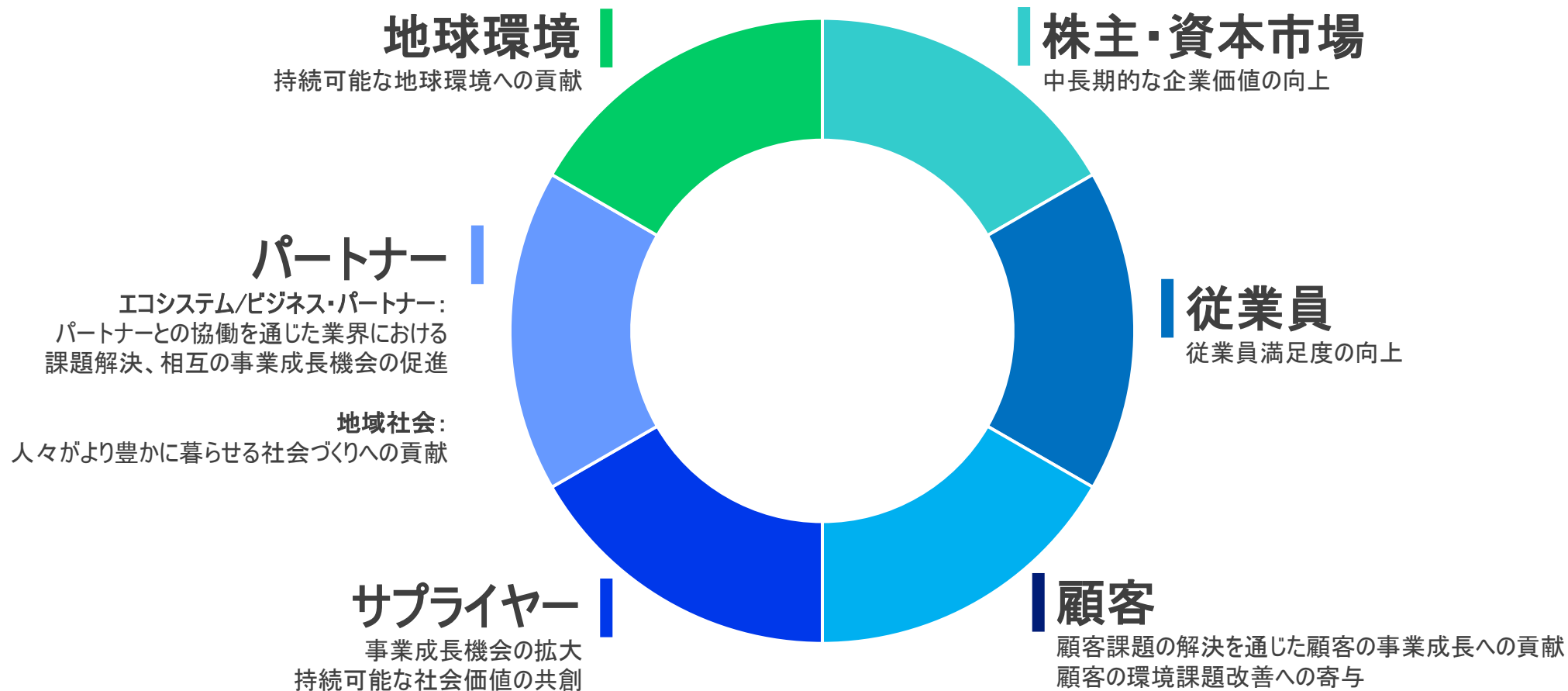
*将来の投資機会や事業環境に応じ、追加的なデットを行う可能性があります

戦略#4

サステナビリティの取り組み強化

ステークホルダーへの提供価値

- ステークホルダーから更なる信頼を勝ち取るよう努めます



企業文化の醸成がすべての源泉



よりサステナブルな地球環境への貢献

■ 地球環境への貢献に関するコミットメント



温室効果ガス 排出量の削減

Scope 1+2目標値 (FY26)

- ▶ スコープ1+2におけるGHG排出量を65%削減 (FY18比)
- ▶ 再生可能エネルギーの導入率を80%に引き上げ
- ▶ 主要製品の工期をFY20比で20%短縮し、エネルギー使用量を削減

Scope 3

- ▶ 製品の環境性能向上
- ▶ サプライチェーンの脱炭素化



サーキュラー・エコノミー への貢献

- ▶ 3Rの推進によりリサイクル率を向上 (3R: Reduce, Reuse, Recycle)
- ▶ 全社の水使用量をFY16の水準で維持



生物多様性や 自然資本の保全

- ▶ 生物多様性の保全、自然保護活動の推進

アドバンテストのパーパス&ミッション

先端技術を 先端で支える





Facing the future together